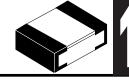




Process Guide R-CHP-00-A

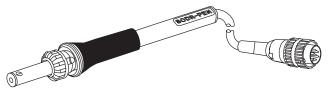
Avlödning av chipkomponent

Flussapplikation





Sodr-pen Lödpenna

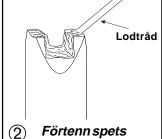


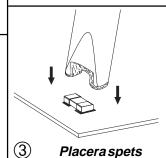
NÖDVÄNDIG UTRUSTNING	PACE ARTIKELNUMMER
PACE SensaTemp [®] Lödstation	
SP-2A Sodr-Pen [®] Lödpenna	6025-0014-P1
SP-2A Spets- & lödpennshållare	6019-0043
CHIP Avlödningspetsar	Se baksida
Spetsverktyg	1100-0296-P1
Rengöringsdyna	6993-0138
TILLVALSUTRUSTNING	
PACE Prep-Set™ Preparationsutrustning (lödgryta)	8007-0186 el.
	7041-0003
Pincetter	Erhålles lokalt
MATERIELL (godkänt av ert företag)	
Lod	Erhålles lokalt
Fluss	Erhålles lokalt
Lösningsmedel	Erhålles lokalt

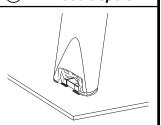
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

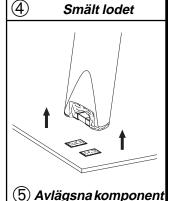
- 1. Avlägsna eventuell beläggning och rengör ytan från all nedsmutsning.
- 2. Inled med en spetstemperatur av 315°C och anpassa sedan efter behov.
- 3. Installera avlödningsspetsen i Sodr-Pen lödpenna, med hjälp av spetsverktyget.
- 4. Applicera fluss på samtliga lödpunkter och lödpaddar. ①
- 5. Avlägsna gammalt lod från spetsen med fiberverktyget.
- 6. Rengör spetsen med svampverktyget.
- 7. Applicera lod på insidan av spetsen eller använd preparationsutrustningen. ②
- 8. Placera spetsen så den får kontakt med chipens lödfogar. 3 & 4
- Kontrollera att lodet smält och avlägsna sedan komponenten från kortet.
 & S Ytspänningen som uppstår är normalt tillräcklig. Om så inte sker, är användningen av pincett ett alternativ)
- 10. Frigör komponenten från spetsen genom att gnida denna mot en värmeresistent vta.
- 11. Förse spetsen med lod och sätt tillbaka lödpennan i sin hållare.
- 12. Förbered för ersättning av komponenten.











CHP-00-A			
00 7.			
YTMONTERING AVLÖDNINGS SPETS	BESKRIVNING (föreslagen applikation)	SPETS STORLEK A X B	ART. NUMMER
B A	Chip Component	2.36mm x 2.03mm (0.093" x 0.080")	1121-0302
B A		3.56mm x 2.03mm (0.14" x 0.08")	1121-0303
D '			